

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年10月10日(10.10.2024)



(10) 国際公開番号
WO 2024/210133 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/038 (2006.01) *C08L 79/08* (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01) *G03F 7/004* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/013638

(22) 国際出願日: 2024年4月2日(02.04.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-060586 2023年4月4日(04.04.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 河内 史彦 (**KAWAUCHI Fumihiko**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). フェルナンデス ギジェルモ (**FERNANDEZ Guillermo**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 牧野 竜也 (**MAKINO Tatsuya**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (**HASEGAWA Yoshiki et al.**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, CURED PRODUCT, AND SEMICONDUCTOR ELEMENT

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、硬化物、及び半導体素子

(57) Abstract: A photosensitive resin composition according to one embodiment of the present disclosure contains a maleimide compound, a crosslinking agent, and a photopolymerization initiator. The maleimide compound is a reaction product of a tetracarboxylic dianhydride, an amine, and a maleic anhydride. The amine includes a dimer diamine and a second amine other than a dimer diamine. The crosslinking agent includes a polymerizable crosslinking agent having a heterocycle that contains a nitrogen atom.

(57) 要約: 本開示の一態様に係る感光性樹脂組成物は、マレイミド化合物と、架橋剤と、光重合開始剤と、を含有し、マレイミド化合物が、テトラカルボン酸二無水物、アミン、及び無水マレイン酸の反応物であり、アミンが、ダイマージアミンと、ダイマージアミン以外の第2のアミンとを含み、架橋剤が、窒素原子を含むヘテロ環を有する重合性架橋剤を含む。

WO 2024/210133 A1